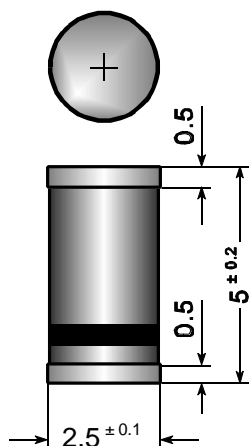


**Superfast Switching
Surface Mount Si-Rectifiers**
**Superschnelle Si-Gleichrichter
für die Oberflächenmontage**


Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	1 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspernung	50...400 V
Plastic case MELF Kunststoffgehäuse MELF	DO-213AB
Weight approx. – Gewicht ca.	0.12 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform getupet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspernung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzenspernung V_{RSM} [V]
SFE 1A	50	50
SFE 1B	100	100
SFE 1C	150	150
SFE 1D	200	200
SFE 1E	250	250
SFE 1F	300	300
SFE 1G	350	350
SFE 1H	400	400

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	10 A ¹⁾
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	4,5 A ² s

¹⁾ Valid, if the temperature of the terminals is kept to 100°C
Gültig, wenn die Temperatur der Anschlüsse auf 100°C gehalten wird

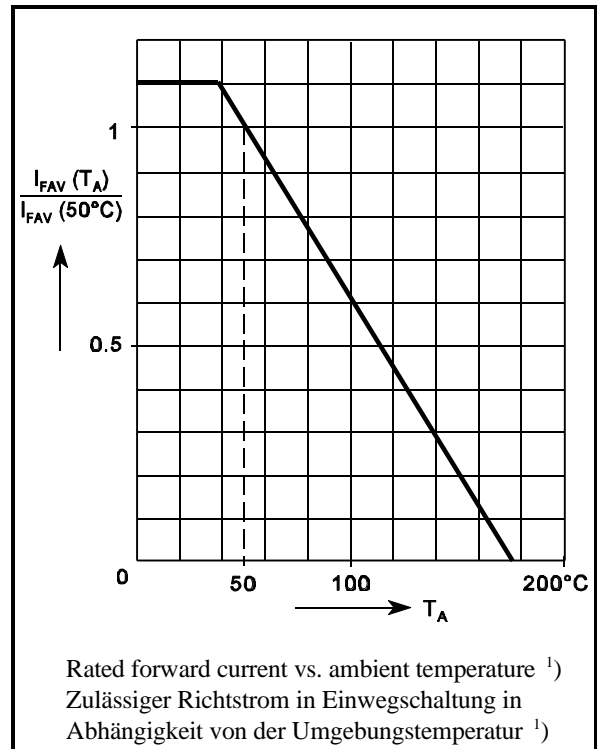
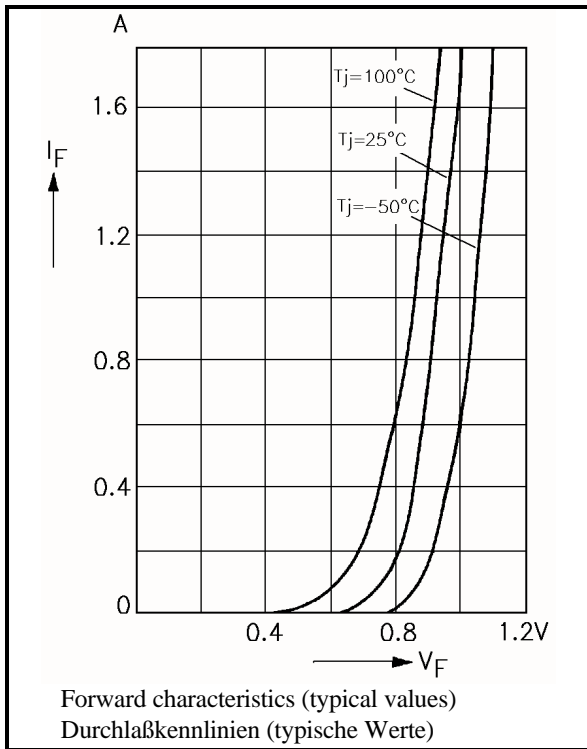
Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 30 A
 superimposed on rated load
 Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen,
 überlagert bei Nennlast

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j – 50...+175°C
 Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s – 50...+175°C

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	V_F	< 1.0 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 5 μA
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to/auf $I_R = 0.25\text{ A}$		t_{rr}	< 50 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	< 45 K/W ¹⁾



¹⁾ Valid, if mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
 Dieser Wert gilt bei Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß